

Title (en)

Pin-shaped contact element to be mounted in the drill holes of a circuit board.

Title (de)

Stiftförmiges Kontaktelement zur Befestigung in Leiterplatten-Bohrungen.

Title (fr)

Élément de contact en forme de fiche pour montage dans les trous de perçage d'une carte à circuits.

Publication

EP 0089491 A2 19830928 (DE)

Application

EP 83101505 A 19830217

Priority

DE 3210348 A 19820320

Abstract (en)

[origin: US4762498A] A pin-shaped contact element to be connected or fastened in a metallized conductor plate bore has a fastening portion with two sidepieces which are movable towards each other and which are connected to each other by a resilient, undulating connecting bridge, the edges of the side pieces which come into contact with the bore walls and the juncture between the bridge and the side pieces being rounded.

Abstract (de)

Für ein stiftförmiges Kontaktelement zur Befestigung in metallisierten Leiterplatten-Bohrungen (13), das einen Befestigungsabschnitt mit zwei gegeneinander beweglichen Seitenteilen (3), die durch einen elastischen Verbindungssteg (9) miteinander verbunden sind, aufweist, ist vorgesehen, den wellenförmigen Verbindungssteg im mittleren Bereich der inneren Fläche der Seitenteile (3) anzuordnen. Weiterhin sind die mit der Bohrungswandung (Metallisierung 15, 16) in Kontakt tretenden Kanten (8) der Seitenteile (3) mit Rundungen versehen.

IPC 1-7

H01R 9/09

IPC 8 full level

H01R 4/02 (2006.01); **H01R 4/04** (2006.01); **H01R 12/58** (2011.01); **H01R 13/42** (2006.01); **H01R 43/04** (2006.01); **H01R 12/50** (2011.01)

CPC (source: EP US)

H01R 12/58 (2013.01 - US); **H01R 12/585** (2013.01 - EP US)

Cited by

EP0132704A3; EP0124767A3; US4954103A; EP0327842A3; US4691979A

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

US 4762498 A 19880809; AT E34252 T1 19880515; DE 3210348 C1 19830811; DE 3376603 D1 19880616; EP 0089491 A2 19830928; EP 0089491 A3 19850731; EP 0089491 B1 19880511; JP H0316219 Y2 19910408; JP H046131 Y2 19920220; JP S58172881 A 19831011; JP S598037 B2 19840222; JP S6249872 U 19870327; JP S6249873 U 19870327

DOCDB simple family (application)

US 47484683 A 19830314; AT 83101505 T 19830217; DE 3210348 A 19820320; DE 3376603 T 19830217; EP 83101505 A 19830217; JP 4250683 A 19830316; JP 7824386 U 19860526; JP 7824486 U 19860526